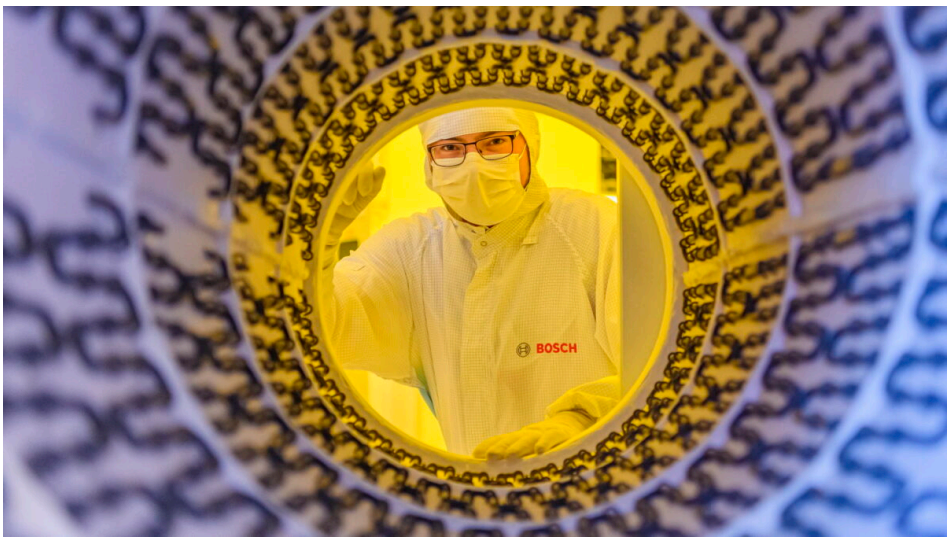
Bosch ordnet Halbleitergeschäft ab 2028 in eigener Sparte neu

Artikel vom **6. November 2026**
Fahrzeugtechnik

Bosch bündelt seine Halbleiteraktivitäten ab Januar 2028 im Geschäftsbereich »Semiconductors«. Damit will das Unternehmen Sensorik, Siliziumkarbid-Chips, ASIC und das Foundry-Geschäft stärker auf Märkte wie Robotik, KI-Rechenzentren und Industrieautomatisierung ausrichten.



Ein Applikationsingenieur prüft im Bosch Halbleiterwerk in Dresden Heizkassetten für Hochtemperaturöfen. (Bild: Bosch/Baldauf)

Halbleiter sind zentrale Bausteine elektronischer Systeme – im Auto, in E-Bikes, Haushaltsgeräten oder Wearables. Mit neuen Anwendungen in Robotik, Industrieautomatisierung und Rechenzentren für künstliche Intelligenz steigt der Bedarf weiter. Die Robert Bosch GmbH will an diesem Wachstum teilhaben und plant, bis 2030 mit Halbleitern einen Umsatz von rund fünf Mrd. Euro zu erreichen. Ab dem 1. Januar 2028 werden die Halbleiteraktivitäten in einem eigenen Geschäftsbereich gebündelt. Die organisatorische Zuordnung zum Unternehmensbereich Mobility bleibt bestehen. Aktuell sind die Aktivitäten noch im Geschäftsbereich Mobility Electronics angesiedelt. Mit der

neuen Struktur sollen Organisation und Prozesse stärker auf die Anforderungen der Halbleiterindustrie ausgerichtet werden. **Neue Märkte für Sensorik und Chips** Das Unternehmen sieht zusätzliche Absatzmöglichkeiten neben dem bestehenden Automobil- und Konsumentengeschäft vor allem in der Robotik. Bereits heute kommen Chips des Unternehmens in humanoiden Robotern zum Einsatz. Hochpräzise Sensoren sollen zudem die Basis für weitere intelligente Systeme bilden. Genannt werden Anwendungen vom Saugroboter bis zum Humanoiden. Auch Rechenzentren für künstliche Intelligenz und die Industrieautomatisierung treiben die Nachfrage. Laut der Presseinformation verweist das Unternehmen auf Studien, nach denen generative KI bis 2030 ein zusätzliches jährliches Volumen von bis zu 3,6 Mio. Halbleiter-Wafern benötigen könnte. Für Europa wird demnach erwartet, dass sich der Bedarf durch Robotik und Industrieautomatisierung bis 2040 verdoppelt. **Foundry-Geschäft und Systemintegration** Mit dem neuen Geschäftsbereich »Semiconductors« will das Unternehmen seine Stärken in der MEMS-Sensorik, bei Siliziumkarbid-Chips und bei anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen ausbauen. Hinzu kommt die Integration von Halbleitern in Systemlösungen. Künftig sollen außerdem Fertigungskapazitäten stärker für externe Partner geöffnet und das Foundry-Geschäft gezielt erweitert werden. Die Halbleiteraktivitäten umfassen weltweit rund 40 Standorte für Forschung, Entwicklung und Fertigung. In den vergangenen Jahren wurden rund drei Milliarden Euro in die Standorte Dresden und Reutlingen investiert. In Roseville, Kalifornien, wird ein Werk für rund zwei Mrd. US-Dollar auf die Fertigung spezieller Siliziumkarbid-Chips umgerüstet. In Penang, Malaysia, ist bis Mitte der nächsten Dekade ein weiterer Ausbau des Testzentrums geplant. Zudem hält das Unternehmen zehn Prozent am Joint Venture European Semiconductor Manufacturing Company GmbH in Dresden. **Mobility Electronics fokussiert Steuergeräte** Der bisherige Geschäftsbereich Mobility Electronics umfasst neben dem Halbleitergeschäft auch das interne Geschäft mit elektronischen Steuergeräten und Leistungselektronik. Ab Januar 2028 soll dieser Bereich auf elektronische Steuergeräte für Automotive-Anwendungen ausgerichtet sein. Damit werden Halbleitergeschäft sowie Steuergeräte und Leistungselektronik organisatorisch klarer getrennt.

Hersteller aus dieser Kategorie

© 2025 Kuhn Fachverlag